

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月8日召开第四届董事会第二十三次会议，于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于预计公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司2026年为合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币242,100万元，担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品提供担保等。其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过75,000万元，为资产负债率70%以上（含）的子公司提供担保的额度不超过167,100万元。

二、本次担保情况

1、根据业务发展需要，博讯光电科技(合肥)有限公司（以下简称“博讯光电”）向东莞银行股份有限公司合肥分行（以下简称“东莞银行”）申请签署授信合同，具体金额以实际签署的授信合同（以下简称“主合同1”）为准。公司与东莞银行于近日签署《最高额保证合同》，同意为主合同1项下债务提供连带责任保证，担保的最高债权额为人民币玖仟万元整及主债权所产生的利息及其他应付款项之和。保证期间为主合同1项下债务人债务履行期限届满之日起三年，具体起算日以合同条款为准。

截至本公告披露日，公司实际为博讯光电提供担保额度总额共计人民币112,800万元（实际使用额度79,277万元），担保额度在已审议通过的担保额度范围内。

2、根据业务发展需要，博晶科技（滁州）有限公司（以下简称“博晶科技”）向上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行（以下简称“浦发银行”）申请签署授信合同，具体金额以实际签署的授信合同（以下简称“主合同2”）为准。公司与浦发银行于近日签署《最高额保证合同》，同意为主合同2项下债务提供连带责任保证，担保的最高债权额为人民币壹亿元整及主债权所产生的利息及其他应付款项之和。保证期间为主合同2项下单笔债务履行期限届满之日起三年，具体起算日以合同条款为准。

截至本公告披露日，公司实际为博晶科技提供担保额度总额共计人民币170,000万元（实际使用额度108,598万元），担保额度在已审议通过的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

（一）博讯光电科技(合肥)有限公司

成立日期：2014年3月10日

注册地址：合肥市新站区大禹路699号

法定代表人：肖志光

注册资本：53,192.40万元人民币

经营范围：一般项目：显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；有色金属合金销售；金属材料销售；建筑材料销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；石油制品制造（不含危险化学品）；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有其 100% 股权。

主要财务指标：

单位：人民币元

主要财务指标	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)
资产总额	2,278,114,311.82	2,478,161,577.17
负债总额	1,726,110,683.98	1,936,037,570.39
净资产	552,003,627.84	542,124,006.78
资产负债率	75.77%	78.12%
营业收入	764,202,642.79	1,232,937,480.07
净利润	8,971,386.68	-47,041,551.21

注：上述数据为单体报表数据

信用情况：博讯光电不是失信被执行人。

（二）博晶科技（滁州）有限公司

成立日期：2021 年 12 月 16 日

注册地址：安徽省滁州市南谯区乌衣镇元山路 57 号

法定代表人：蔡姬妹

注册资本：80,000 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子元器件批发；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属制品研发；金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；淬火加工；喷涂加工；真空镀膜加工；电泳加工；塑胶表面处理；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；新型膜

材料制造；新型膜材料销售；表面功能材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；新型有机活性材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；知识产权服务（专利代理服务除外）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；物业管理；技术进出口；货物进出口；电子专用设备销售；塑料加工专用设备销售；数控机床销售；金属成形机床销售；机械电气设备销售；机械设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有其 76.3243%股权，复星智联新能（安徽）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有其 11.1757%股权，滁州初芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有其 9.9490%股权，厦门 TCL 科技产业投资有限公司持有其 2.5510%股权。

主要财务指标：

单位：人民币元

主要财务指标	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	3,052,778,956.25	2,432,061,807.87
负债总额	2,498,870,775.77	1,797,456,393.76
净资产	553,908,180.48	634,605,414.11
资产负债率	81.86%	73.91%
营业收入	1,557,915,019.32	687,088,212.09
净利润	-79,617,449.15	-121,637,859.04

注：上述数据为单体报表数据

信用情况：博晶科技不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

（一）与东莞银行签署的《最高额保证合同》

被担保方：博讯光电科技(合肥)有限公司；

债权人：东莞银行股份有限公司合肥分行；

保证人：翰博高新材料（合肥）股份有限公司；

担保金额：担保的最高债权额为人民币玖仟万元整及主债权所产生的利息及其他应付款项之和；

保证方式：连带责任保证；

保证期间：主合同 1 项下债务人债务履行期限届满之日起三年，具体起算日以合同条款为准。

（二）与浦发银行签署的《最高额保证合同》

被担保方：博晶科技（滁州）有限公司；

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行；

保证人：翰博高新材料（合肥）股份有限公司；

担保金额：担保的最高债权额为人民币壹亿元整及主债权所产生的利息及其他应付款项之和；

保证方式：连带责任保证；

保证期间：主合同 2 项下单笔债务履行期限届满之日起三年，具体起算日以合同条款为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保情况如下：

被担保方	担保额度 (万元)	实际担保余额 (万元)	公告披露日期	是否资产负债率超过70%
重庆博硕光电有限公司	19,000	12,069	2024/11/20	否
	11,000	10,137	2026/1/30	
	3,000	2,768	2026/3/18	
	6,000	1,500	2026/2/13	
	5,000	0	2026/2/13	

被担保方	担保额度 (万元)	实际担保余额 (万元)	公告披露日期	是否资产负债率超过70%
	6,000	3,196	2023/5/22	
	2,000	2,000	2026/2/13	
小计	52,000	31,670	-	
博讯光电科技(合肥)有限公司	13,000	10,195	2024/4/18	是
	10,000	8,750	2022/1/27	
	10,000	8,778	2024/2/23	
	7,000	5,761	2025/4/11	
	10,000	5,700	2025/5/28	
	10,000	9,996	2025/10/28	
	7,800	5,911	2024/4/9	
	10,000	6,000	2024/12/12	
	20,000	13,186	2025/9/10	
	9,000	0	本次新增	
	6,000	5,000	2025/12/19	
小计	112,800	79,277	-	
合肥星辰新材料有限公司	2,000	1,487	2024/3/19	否
	500	500	2026/1/30	
	500	500	2025/6/23	
小计	3,000	2,487	-	
博晶科技(滁州)有限公司	150,000	99,529	2022/4/29	是
	10,000	3,919	本次续签	
	5,000	4,950	2025/6/23	
	2,000	200	2025/8/13	
	3,000	0	2025/8/13	
小计	170,000	108,598		
博昇科技(滁州)有限公司	5,000	4,299	2025/6/23	是
小计	5,000	4,299		
青岛欧迅光电有限公司	1,000	1,000	2025/3/20	否
小计	1,000	1,000		
合肥芯东进新材料科技有限公司	31,818	6,575	2026/4/1	不适用

被担保方	担保额度 (万元)	实际担保余额 (万元)	公告披露日期	是否资 产负 债 率 超 过 70%
小计	31,818	6,575		
重庆翰博显示科技有限公 司、重庆翰博显示科技研 发中心有限公司(注1)	27,500	19,038	2020/10/13	是
小计	27,500	19,038	-	
合计	403,118	252,943	-	-

注1:重庆翰博显示科技有限公司与重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司(简称“两江投资公司”)于2020年10月22日签署《翰博高新背光模组和研发中心项目代建协议》,重庆翰博显示科技有限公司委托两江投资公司建设翰博高新背光模组和研发中心项目,公司提供保证,保证期间到代建合同债务结束。

注2:若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,系由四舍五入导致。

截至本公告披露日,公司及其控股子公司已审议通过的累计可对外担保总额为46.05亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为441.88%。本次提供担保后,公司及其控股子公司签署的担保合同处于有效期内的担保总额为40.31亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为386.81%,实际担保余额为25.29亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为242.71%。其中,为参股公司签署的担保合同处于有效期内的担保总额为31,818.15万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为30.53%,实际担保余额为6,574.90万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为6.31%,其他担保均系公司合并报表范围内公司之间提供的担保。

截至本公告披露日,公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

六、备查文件

《最高额保证合同》。

特此公告。

翰博高新材料(合肥)股份有限公司
董事会

2026年4月10日